

# Роль объемного заряда в формировании сопротивления биполярного полупроводникового образца

© А. Конин

Институт физики полупроводников,  
2600 Вильнюс, Литва

(Получена 4 июля 2003 г. Принята к печати 2 июля 2003 г.)

В линейном приближении по концентрациям неравновесных носителей заряда получено выражение, описывающее не зависящее от протекающего тока сопротивление биполярного полупроводника (закон Ома). Показано, что отклонение сопротивления от классического обусловлено возникающим в полупроводнике объемным зарядом. В зависимости от соотношения приповерхностных проводимостей электронов и дырок сопротивление образца может стать как больше, так и меньше классического. Этот эффект максимален в образцах с малой поверхностной рекомбинацией, длина которых значительно меньше диффузионной длины.

## 1. Введение

В ряде физических задач, связанных с возникновением в полупроводнике неравновесных электронов и дырок (фотоэффект, инжекция носителей, эффект Холла и т. д.), принципиальную роль играет их рекомбинация. Выражения для темпов объемной рекомбинации были получены в [1] на основании модели Шокли–Рида [2] в линейном приближении по концентрациям неравновесных носителей. Предложенная в [1] модель рекомбинации была использована в [3] для вычисления сопротивления биполярного полупроводникового образца. Полученные в [4,5] и использованные в [3] граничные условия (ГУ) достаточны для вычисления констант интегрирования только в предположении квазинейтральности образца и не являются корректными по нескольким причинам. В [3] предполагается, что неравновесные концентрации электронов  $\Delta n$  и дырок  $\Delta p$  равны во всем объеме образца ( $\Delta n = \Delta p$ ) — так называемое условие квазинейтральности. При этом выпадает из рассмотрения заряд, возникающий в приконтактной области полупроводника, толщина которой порядка дебаевской длины (дебаевский заряд). Кроме того, сокращается количество неизвестных — фактически неизвестной функцией является только неравновесная концентрация электронно-дырочных пар (ЭДП). Для нахождения последней вполне достаточно известных ГУ [6], связывающие поток ЭДП со скоростью их рекомбинации на поверхности. ГУ в этом случае формулируются вне области приповерхностного дебаевского заряда [7] на некой квазиповерхности, а не реальной границе металл–полупроводник. Следствием квазинейтральности является также и то, что электрическое поле в образце однозначно определяется градиентом концентрации неравновесных ЭДП. При этом возникает новое противоречие — с одной стороны, электрическое поле является нелинейной функцией координаты образца, а с другой — согласно уравнению Пуассона, от координаты не зависит. Все эти противоречия можно устранить, если точно решить систему уравнений непрерывности [1] с учетом уравнения Пуассона и использовать ГУ на реальной границе

металл–полупроводник. При этом автоматически будут учтены возникающие объемный диффузионный и приповерхностный дебаевский заряды и создаваемый ими электростатический потенциал.

Цель настоящей работы — нахождение сопротивления биполярного полупроводникового образца с учетом ГУ на реальной границе металл–полупроводник.

## 2. Теория

Рассмотрим полупроводниковый образец, имеющий форму параллелепипеда ( $-a \leq x \leq a$ ,  $0 \leq y \leq b$ ,  $0 \leq z \leq d$ ), причем  $a \ll b, d$ . Вдоль оси  $x$  через образец пропущен постоянный электрический ток  $j_0$ .

Распределение концентраций носителей и электростатического потенциала определяются уравнениями непрерывности [1]

$$\frac{1}{e} \frac{dj_n}{dx} - \frac{\Delta n}{\tau_n} - \frac{\Delta p}{\tau_p} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{e} \frac{dj_p}{dx} + \frac{\Delta n}{\tau_n} + \frac{\Delta p}{\tau_p} = 0 \quad (2)$$

и уравнением Пуассона

$$\frac{d^2 \Delta \varphi}{dx^2} = \frac{e}{\varepsilon \varepsilon_0} (\Delta n - \Delta p), \quad (3)$$

где  $j_n, j_p$  — плотности токов электронов и дырок,  $\tau_n$  и  $\tau_p$  — параметры полупроводника, имеющие размерность времени, но не являющиеся временами жизни электронов и дырок [1],  $\Delta n$  и  $\Delta p$  — неравновесные концентрации электронов и дырок,  $\Delta \varphi$  — неравновесный электростатический потенциал,  $(-e)$  — заряд электрона,  $\varepsilon$  — диэлектрическая проницаемость полупроводника,  $\varepsilon_0$  — электрическая постоянная.

Уравнения (1) и (2) удовлетворяют, как и должно быть, закону сохранения заряда

$$\frac{d}{dx} (j_n + j_p) = 0,$$

из которого следует, что

$$j_n + j_p = j_0 = \text{const.} \quad (4)$$

Сформулируем граничные условия для уравнений (1)–(3). Выражения для токов электронов и дырок в самом общем случае в линейном приближении по изменению электрического и химического потенциалов имеют вид

$$j_n = \sigma_n \left[ -\frac{d}{dx} \left( \Delta\varphi - \frac{1}{e} \Delta F_n \right) \right],$$

$$j_p = \sigma_p \left[ -\frac{d}{dx} \left( \Delta\varphi + \frac{1}{e} \Delta F_p \right) \right], \quad (5)$$

где  $\sigma_{n(p)}$  — электронная (дырочная) электропроводность полупроводника,  $\Delta F_{n(p)}$  — изменение химических потенциалов электронов и дырок, обусловленное изменением их концентраций.

Для вывода граничных условий для потока дырок к поверхности  $x = a$  проинтегрируем (2) по  $x$  от  $a - \delta$  до  $a + \delta$  и устремим  $\delta$  к нулю. Получаем

$$\frac{1}{e} \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a-\delta}^{a+\delta} \frac{dj_p}{dx} dx + \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a-\delta}^{a+\delta} \left( \frac{\Delta n}{\tau_n} + \frac{\Delta p}{\tau_p} \right) dx = 0. \quad (6)$$

Принимая во внимание, что  $j_p(a + \delta) = 0$  (дырок в металле нет), окончательно находим

$$\frac{1}{e} j_p|_{x=a} = S_n^+ \Delta n|_{x=a} + S_p^+ \Delta p|_{x=a}, \quad (7)$$

где

$$S_{n,p}^+ = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a-\delta}^a \frac{dx}{\tau_{n,p}}$$

— параметры, характеризующие рекомбинационные свойства поверхности, но не являющиеся в строгом смысле этого слова скоростями поверхностной рекомбинации электронов и дырок. Аналогично для поверхности  $x = -a$  находим

$$\frac{1}{e} j_p|_{x=-a} = -S_n^- \Delta n|_{x=-a} - S_p^- \Delta p|_{x=-a}, \quad (8)$$

где

$$S_{n,p}^- = \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_0^\delta \frac{dx}{\tau_{n,p}}.$$

Поскольку условие (4) справедливо во всем объеме полупроводника и на его границе с металлом, дополнительные ГУ для  $j_n$  выводить не надо.

При выводе ГУ (11), (12) считалось, что поверхностные центры рекомбинации находятся в тонком приповерхностном слое, толщина которого значительно меньше длины Дебая (см. определение величин  $S_{n,p}^\pm$ ). Таким образом, в отличие от ранее использовавшихся ГУ [3–5],

в этой модели учитывается влияние приповерхностного дебаевского заряда на величину возникающей эдс через  $\Delta n|_{x=\pm a}$  и  $\Delta p|_{x=\pm a}$  на реальной границе металл–полупроводник.

Используем теперь фундаментальное условие (4), являющееся следствием закона сохранения заряда, для получения ГУ для неравновесных электрического и химического потенциалов. Для этого подставим (5) в тождество (4). Получаем

$$\frac{\sigma_n}{e} \frac{d\Delta F_n}{dx} - \frac{\sigma_p}{e} \frac{d\Delta F_p}{dx} - (\sigma_n + \sigma_p) \frac{d\Delta\varphi}{dx} = j_0. \quad (9)$$

Проинтегрируем (9) по  $x$  от  $a - \delta$  до  $a + \delta$  и устремим  $\delta$  к нулю

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a-\delta}^{a+\delta} \frac{\sigma_n}{e} \frac{d\Delta F_n}{dx} dx - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a-\delta}^{a+\delta} \frac{\sigma_p}{e} \frac{d\Delta F_p}{dx} dx,$$

$$- \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a-\delta}^{a+\delta} (\sigma_n + \sigma_p) \frac{d\Delta\varphi}{dx} - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{a-\delta}^{a+\delta} j_0 dx = 0. \quad (10)$$

Последний интеграл в (10) равен нулю, так как подынтегральная функция конечна. Предпоследний интеграл в (10) может иметь конечное значение только при наличии скачка  $\Delta\varphi$  на границе. Напомним, что  $\Delta\varphi$  — это изменение потенциала, вызванное протеканием постоянного электрического тока  $j_0$  через образец. Физической причиной, которая может привести к скачку  $\Delta\varphi$ , является падение напряжения на конечном сопротивлении металл–полупроводник:

$$\Delta\varphi|_{x=\mp a} - \Delta\varphi_M|_{x=\mp a} = \pm \frac{j_0}{\sigma_S^\mp}, \quad (11)$$

где  $\Delta\varphi_M$  — изменение электрического потенциала металлического контакта,  $\sigma_S^\pm$  — поверхностная электропроводность образца (размерность  $\sigma_S^\pm$  —  $1/\text{Ом} \cdot \text{см}^2$ ).

Учитывая постоянство химического потенциала металлического контакта, из (10) и (11) получаем

$$\frac{1}{e} \sigma_p^+ \Delta F_p|_{x=a} - \frac{1}{e} \sigma_n^+ \Delta F_n|_{x=a} - \frac{\sigma_n^+ + \sigma_p^+}{\sigma_S^+} j_0 = 0, \quad (12)$$

где  $\sigma_{n,p}^+ = \lim_{x \rightarrow a-0} \sigma_{n,p}$  — электропроводность электронов и дырок вблизи поверхности  $x = a$  со стороны полупроводника (приповерхностные электропроводности). Размерности приповерхностных электропроводностей  $\sigma_{n,p}^+$  такие же, как и объемных —  $1/\text{Ом} \cdot \text{см}$ .

Аналогично для поверхности  $x = -a$  находим

$$\frac{1}{e} \sigma_p^- \Delta F_p|_{x=-a} - \frac{1}{e} \sigma_n^- \Delta F_n|_{x=-a} - \frac{\sigma_n^- + \sigma_p^-}{\sigma_S^-} j_0 = 0, \quad (13)$$

где  $\sigma_{n,p}^- = \lim_{x \rightarrow -a+0} \sigma_{n,p}$ .

Если поверхностная электропроводность на контакте металл–полупроводник достаточно велика (контакт омический), то (11) можно записать так:

$$\Delta\varphi_M|_{x=\pm a} = \Delta\varphi|_{x=\pm a}. \quad (14)$$

Соотношение (14) тем более имеет место при  $j_0 = 0$ . В этом случае из (12) и (13) получаем

$$\sigma_n^\pm \Delta F_n|_{x=\pm a} = \sigma_p^\pm \Delta F_p|_{x=\pm a}. \quad (15)$$

В дальнейшем граничные условия считаем симметричными:  $S_{n(p)}^+ = S_{n(p)}^- = S_{n(p)}$ ,  $\sigma_{n(p)}^+ = \sigma_{n(p)}^- = \sigma_{n(p)}^S$ , а контакты — омическими. Решая уравнения (1)–(3) с граничными условиями (14), (15) и дополнительным условием (4), получаем

$$\Delta n = j_0 \frac{eF_0}{kT} \left[ \operatorname{sh} \frac{x}{\lambda} + \frac{(\theta n_0/p_0 - 1)}{(1 + \theta)} \frac{\operatorname{sh} x/r_D}{\operatorname{sh} a/r_D} \right], \quad (16)$$

$$\Delta p = j_0 \frac{eF_0}{kT} \left[ \left( 1 - \frac{(n_0 + p_0)(\mu_n - \mu_p)}{(n_0\mu_n + p_0\mu_p)} \frac{r_D^2}{\lambda^2} \right) \operatorname{sh} \frac{x}{\lambda} - \frac{p_0}{n_0} \frac{(\theta n_0/p_0 - 1)}{(1 + \theta)} \frac{\operatorname{sh} x/r_D}{\operatorname{sh} a/r_D} \right], \quad (17)$$

$$\Delta\varphi = j_0 F_0 \left[ \frac{(\theta n_0 - p_0)}{n_0 p_0 (1 + \theta)} \frac{\operatorname{sh} x/r_D}{\operatorname{sh} a/r_D} + \frac{(\mu_n - \mu_p)}{(n_0\mu_n + p_0\mu_p)} \frac{\operatorname{sh} x/\lambda}{\operatorname{sh} a/\lambda} \right] - j_0 \frac{x}{e(n_0\mu_n + p_0\mu_p)}, \quad (18)$$

где

$$F_0 = \frac{\lambda}{D_S} \frac{p_0}{e\mu_n(n_0 + p_0)},$$

$$D_S = \operatorname{cth} \frac{a}{\lambda} + \frac{(n_0 + p_0)}{(1 + \theta)} \left( \frac{v_n}{p_0} \theta + \frac{v_p}{n_0} \right), \quad (19)$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{kT}{e} \frac{(n_0 + p_0)\mu_n\mu_p}{(n_0\mu_n + p_0\mu_p)}} \tau$$

— диффузионная длина,

$$r_D = \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0 kT}{e^2(n_0 + p_0)}}$$

— радиус Дебая,  $v_{n,p} = S_{n,p}\tau/\lambda$ ,  $\theta = \sigma_p^S/\sigma_n^S$ ,  $\tau = \tau_n\tau_p/(\tau_n + \tau_p)$  — время жизни неравновесных электронно-дырочных пар (ЭДП) в объеме образца.

Из сравнения выражений (16), (17) видно, что в полупроводнике действительно возникает объемный заряд, который и приводит к перераспределению потенциала (член в квадратных скобках (18)).

Из (14) и (18) следует, что падение напряжения на образце  $U = \Delta\varphi_M(-a) - \Delta\varphi_M(a)$  равно

$$U = j_0 \frac{2a}{e(n_0\mu_n + p_0\mu_p)} \left[ 1 - \frac{\lambda}{aD_S} \frac{(\theta n_0\mu_n - p_0\mu_p)}{n_0\mu_n(1 + \theta)} \right]. \quad (20)$$

Из уравнения (20) находим сопротивление образца

$$R = R_0 \left[ 1 - \frac{\lambda}{aD_S} \frac{(\theta n_0\mu_n - p_0\mu_p)}{n_0\mu_n(1 + \theta)} \right], \quad (21)$$

где  $R_0 = \frac{2a}{ebd(n_0\mu_n + p_0\mu_p)}$  — классическое сопротивление образца.

Заметим, что при  $\sigma_{n(p)}^S = \sigma_{n(p)}$  сопротивление образца равно классическому значению вне зависимости от величин  $S_{n,p}$  и толщины образца. Этот результат достаточно очевиден, так как в этом случае отсутствует физическая граница металл–полупроводник. С другой стороны, он является подтверждением правильности ГУ (14) и (15). Экспериментально такую ситуацию можно реализовать на образце „гантелеобразной“ формы, вырезанном из кристалла полупроводника. При выводе (16)–(18) предполагалось, что диффузионная длина значительно больше радиуса Дебая.

### 3. Обсуждение результатов

Из (13) следует, что при интенсивной рекомбинации носителей ( $S_{n,p} \gg \lambda/\tau$ ) на поверхностях  $x = \pm a$  сопротивление образца равно классическому  $R = R_0$ , так как неравновесных носителей в образце нет.

Рассмотрим подробнее случай малой поверхностной рекомбинации носителей  $S_{n,p} \ll \lambda/\tau$ . При этом сопротивление образца равно

$$R = R_0 \left[ 1 - \frac{(\theta n_0\mu_n - p_0\mu_p)}{(1 + \theta)n_0\mu_n} \frac{\lambda}{a} \operatorname{th} \frac{a}{\lambda} \right]. \quad (22)$$

В коротких образцах ( $a \ll \lambda$ ) из (22) получаем

$$R = R_0 \frac{(n_0\mu_n + p_0\mu_p)}{n_0\mu_n(1 + \theta)}. \quad (23)$$

Из (23) следует, что при  $\theta \ll 1$  ( $\sigma_p^S \ll \sigma_n^S$ )

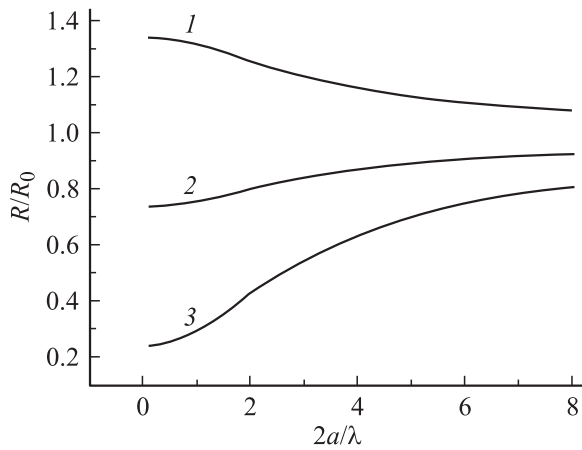
$$R = \frac{2a}{ebdn_0\mu_n}, \quad (24)$$

т.е. в этом случае сопротивление образца определяется только электронами и имеет максимальную величину. При  $\theta \gg 1$  ( $\sigma_p^S \gg \sigma_n^S$ ) из (23) получаем

$$R = \frac{2a}{ebdn_0\mu_n} \frac{\sigma_n^S}{\sigma_p^S}, \quad (25)$$

т.е. сопротивление образца становится значительно меньше классического.

Рассмотрим подробно причины возникновения такого необычного эффекта. Как следует из (16), (17), неравновесные ЭДП в объеме (члены  $\propto \operatorname{sh} x/\lambda$ ) сносятся током  $j_0$  от анода к катоду, поэтому их концентрация вблизи поверхности  $x = a$  положительна. Из граничного



Зависимость нормированного сопротивления образца Ge от его длины при различных значениях  $\theta$ : 1 — 0,1, 2 — 1, 3 — 5.  $T = 310$  К.

условия (12) с учетом омичности контактов получаем

$$\Delta n(a) = \frac{n_0}{p_0} \frac{\sigma_p^S}{\sigma_n^S} \Delta p(a),$$

а поскольку  $\sigma_p^S \gg \sigma_n^S$ , то  $\Delta n(a) \gg \Delta p(a)$ , причем концентрации неравновесных носителей положительны. Следовательно, у поверхности  $x = a$  на расстоянии дебаевского радиуса возникает отрицательный поверхностный заряд, а электростатический потенциал контакта повышается.

Из (18) получаем распределение электростатического потенциала в коротких образцах при малой поверхностной рекомбинации:

$$\Delta \varphi = -\frac{j_0}{e\mu_n(n_0 + p_0)} \left[ x - a \frac{(\theta - p_0/n_0) \operatorname{sh} x/r_D}{(1 + \theta) \operatorname{sh} a/r_D} \right]. \quad (26)$$

Из (26) следует, что при  $\theta \ll 1$   $\varphi$  — монотонно уменьшающаяся функция  $x$ , а электрическое поле положительно во всех точках образца. При  $\theta \gg 1$   $\varphi$  — немонотонная функция  $x$ , имеющая экстремумы на расстояниях  $r_D \ln a/r_D$  от поверхностей образца, в результате чего электрическое поле в приповерхностных областях становится отрицательным.

На рисунке представлена зависимость сопротивления образца собственного Ge ( $T = 310$  К,  $\lambda = 0.1$  см,  $\mu_n = 3800$  см<sup>2</sup>/В·с,  $\mu_p = 1800$  см<sup>2</sup>/В·с) от его длины при различных отношениях приповерхностных проводимостей  $\theta$  в случае  $S_{n,p} \ll \lambda/\tau$ . Как видим, сопротивление существенным образом зависит от величины  $\theta$ , особенно в коротких образцах.

#### 4. Заключение

Показано, что при симметричных граничных условиях отклонение сопротивления от классического обусловлено возникающим в полупроводнике объемным зарядом. Объемный заряд формируется не только на дебаевском

радиусе от поверхности образца, но и на диффузионной длине. В зависимости от соотношения приповерхностных проводимостей электронов и дырок сопротивление образца может стать как больше, так и меньше классического. Этот эффект максимален в образцах, поверхностная рекомбинация которых достаточно мала, а длина — значительно меньше диффузионной.

#### Список литературы

- [1] И.Н. Воловичев, Ю.Г. Гуревич. ФТП, **35**, 321 (2001).
- [2] W. Shockley, W.T. Read. Phys. Rev., **87**, 835 (1952).
- [3] Ю.Г. Гуревич, Г.Н. Логвинов, Г. Эспехо, О.Ю. Титов, А. Мериуц. ФТП, **34**, 783 (2000).
- [4] Yu.G. Gurevich. J. Thermoelectricity, № 2, 5 (1997).
- [5] O.Yu. Titov, J. Giraldo, Yu.G. Gurevich. Appl. Phys. Lett., **80**, 3108 (2002).
- [6] Г.Е. Пикус. ЖТФ, **26**, 22 (1956).
- [7] Г.П. Пека. Физические явления на поверхности полупроводников (Киев, Вища шк., 1984).

Редактор Л.В. Беляков

#### The role of bulk charge in formation of the resistance of a bipolar semiconductor

A. Konin

Semiconductor Physics Institute,  
2600 Vilnius, Lithuania

**Abstract** The expression for the resistance of a bipolar semiconductor in linear approximation under non-equilibrium electron and hole densities is obtained. It is shown that the deviation of resistance from its classical value is conditioned by a bulk charge, which arises in the sample. The resistance of semiconductor sample can be greater or smaller than its classical value being the function of electron-hole electrical conductivity near the surface. This effect has a maximum value in the samples with ineffective surface recombination, when the sample length is smaller than the diffusion length.